

# 均溫板 Vapor Chamber

## 產品特性 Features

- 二維面傳導  
Two-dimentional heat transfer
- 被動元件  
Passive component
- 高穩定性  
High stability
- 較熱管高十倍性能  
10 times efficiency higher than heat pipe

## 產品應用端 Application:

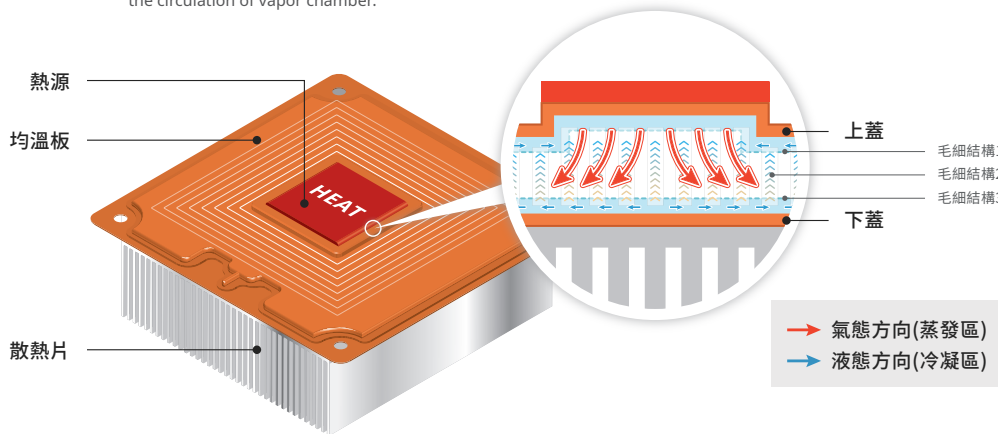
極適用於高效能散熱應用 Best for high performance applications

電子元件 Electronic components - 5G, Aerospace, AI, AIoT, AR/VR/MR/XR, Automotive, Consumer Devices, Datalog, Electric Vehicle, Electronic Products, Energy Storage, Industrial, Lighting Equipment, Medical, Military, Netcom, Panel, Power Electronics, Robot, Servers, Smart Home, Telecom, etc.

## 散熱機制 Mechanism

均溫板是二維熱傳方式，可以解決更嚴苛與高效率的散熱問題。內部有毛細結構的真空封閉腔體，工作液體吸收熱量後迅速汽化，並往冷凝區移動，經熱交換後凝結成液態回流，周而復始的循環。

Vapor chamber is two-dimensional thermal conduction. Therefore, it is a more efficient heat dissipation way for solve higher level thermal problem. The inside of vapor chamber is a capillary structure vacuum chamber. After the working fluid absorbs the heat, it will vaporize rapidly and flow to cooling zone. When it exchanged heat with the external, it will condense back to fluid and flow back to heat zone. This is the circulation of vapor chamber.



## 專案流程 Project process

- Step 1 | 提供需求**  
顧客由網站提供需求  
專業產品顧問將與您接洽
- Step 2 | 專案討論**  
產品機構條件  
相關需求確認
- Step 3 | 提供對策**  
產品顧問提供  
熱處理對策
- Step 4 | 進度追蹤**  
方便顧客追蹤流程  
以準時達成目標

## 選擇指南 Design Guide

※ 熱源大小 Heat Size 30X30 mm

Size (mm)	Q-Max			Thickness (mm)		
	2.0	3.0	4.0	2.0	3.0	4.0
60X80	50	70	90			
90X90	80	120	160			
100X100	140	200	260			
120X80	130	200	250			
180X150	160	250	300			
200X120	200	300	400			
350X100	220	350	450			

高柏科技團隊提供訂製設計。如有產品需求請聯絡我們

## 高柏科技 T-Global Technonology Co., Ltd.

桃園市桃園區大仁路 50 巷 33 號 No.33, Ln.50, Daren Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330058, Taiwan  
T +886-3-361-8899 E service@tglobalcorp.com W www.tglobalcorp.com

Version19  
20230721



注意：本技術數據表內的資訊是根據高柏團隊的研究與測試得出的最佳數據。本技術數據表中列出的值僅代表典型值，並非對每一批生產的物料都進行測試。所有規格如有變更，恕不另行通知；無影響產品功能之保護膜及離型紙，如非特殊要求，皆依高柏默認為準。由於各種可能的使用條件超出了我們的控制範圍，因此我們提出的所有建議均不構成保證或責任，用戶應自行進行測試，以確定我們的產品在任何特定情況下的適用性。本產品的銷售沒有任何明示或暗示的說明，表示其適用於特定目的或其他用途的保證，但本產品應依據高柏與您確認的發票、報價、或訂單，提供最標準的產品質量。我們不承擔使用者如何延伸或改變此技術數據表中的資訊，使用者應承擔所有風險。此外，本技術數據表中的資訊不包含任何內容解釋與涉及產品材料的現有用途、未來專利衝突、工藝製造、與使用產品的建議。高柏科技為了能提供客戶更高效能的導熱介面材料，針對部分產品更新製程並整合 UL 認證規格，自今日起我們將逐漸以 TG-A 系列料號取代部分上一代產品。